

【ハイウェイテクノフェア2023】に出展しました

■当社は2023年11月9日(木)～10日(金)の2日間、東京国際展示場(東京ビックサイト)の西3・4ホールで開催された【ハイウェイテクノフェア2023】に出展しました。

■当社は、今回も親会社である三井住友建設(株)との共同ブースで出展しており、建設関連分野に係る新材料・新工法・その他時代のニーズに対応して開発された新技術を公開しました。

■当社の出展技術

- ★ ロードケア Z・R (全天候型常温合材)
- ★ ロードケアシール (舗装コールドジョイント止水材) ・ シールセッター
- ★ ハイパーアスコン (高耐久・高強度舗装技術)
- ★ ロードケアフォーミング (低炭素混合物の製造技術)

(上記技術は当社ホームページにも掲載しております。)



(展示物 配置状況)



(展示物 配置状況)

2023 ハイウェイテクノフェア